

Product Data Sheet / Produkt Datenblatt

Part Number	5007.HSD.1X10.00Z	Teilenummer
Description	HSD - Anbaustecker HSD - pcb mount plug	Beschreibung
Design according to		Ausführung nach

Preliminary

Vorläufig

Electrical characteristics / Elektrische Eigenschaften

		colored value means: still under test target value		
		Value/Wert	Unit/Einheit	
Impedance (MIL-C-39012B)		100+/-10%	[Ω]	Impedanz (MIL-C-39012B)
Operating frequency up to		2	[GHz]	Betriebsfrequenz bis zu
Data bit rate		5	[Gbit/s]	Daten Bitrate
Return loss				Rückflusdämpfung
	1 GHz	≥ 20	[dB]	
	2 GHz	≥ 17	[dB]	
Insertion loss		≤ 0,1	[dB]	Einfügedämpfung
Insulation resistance		≥ 1x 10 ³	[MΩ]	Isolationswiderstand
Contact resistance				Kontakt-Widerstand
Centre contact		≤ 10	[mΩ]	Innenkontakt
Outer contact		≤ 7,5	[mΩ]	Außenkontakt
Contact current max. (DC)		≤ 1,5	[A] DC	Kontakt-Strombelastbarkeit max (DC)
Operating voltage		max. 100	[V] DC	Betriebsspannung
Proof voltage		min. 250	[V] eff	Prüfspannung
RF Leakage	up to 1GHz	≥ 75	[dB]	Schirmdämpfung
	up to 2GHz	≥ 65	[dB]	
Nearend crosstalk		≤ 33	[dB]	Übersprechen nahes Ende
Farend crosstalk		≤ 28	[dB]	Übersprechen fernes Ende
Skew (between signal contacts)		≤ 5	[psec]	Laufzeitunterschied

Mechanical characteristics / Mechanische Eigenschaften

		Value/ Wert	Unit/Einheit	
Engagement force		≤ 30	[N]	Steckkraft
Separating force		≥ 5	[N]	Ziehkraft
Mating cycles		≥ 25		Steckzyklen
Coding efficiency		≥ 80	[N]	Kodierungseffizienz
Retention force locked system		≥ 110	[N]	Bauteilfestigkeit

Product Data Sheet / Produkt Datenblatt

Part Number	5007.HSD.1X10.00Z	Teilenummer
Description	HSD - Anbaustecker HSD - pcb mount plug	Beschreibung

Material & plating / Material & Oberfläche

RoHS (2002/95/EC) conform		
	Material/Material	Plating/Oberflächen
Outer contact	Brass	Ni 3-6µm
Centre contact	Brass	Au min. 0,15µm
Plastic housing	PA 10T/X (UL94-HB)	
Other metal parts	Zink alloy	Cu+Ni+Tin plated
Insulator	LCP (UL94-VV0)	

Environmental influences: Umwelteinflüsse

Operating temperature range	-40°C up to +105°C	Betriebstemperaturbereich
Thermal shock	DIN IEC 60068-2-14 Test NA	Temperaturwechsel
Temperature and Humidity	USCAR 2-4 5.6.2	Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Vibration (Random)	DIN IEC 60068-2-64	Vibration (Rauschen)
Mechanical Shock	DIN IEC 60068-2-27	Mechanischer Schock
High-Temp. Exposure	DIN IEC 60068-2-2	Trockene Wärme
Solder profile	IEC 60068-2-58 Group 3&4	Lötprofil

Notes: Aufzeichnungen

Update History

Rev.	Date	Alteration	Signature

Formblatt-Nr.: Form-TK-012b	
Rev.	02
Released	21. Nov 13

Product Data Sheet / Produkt Datenblatt

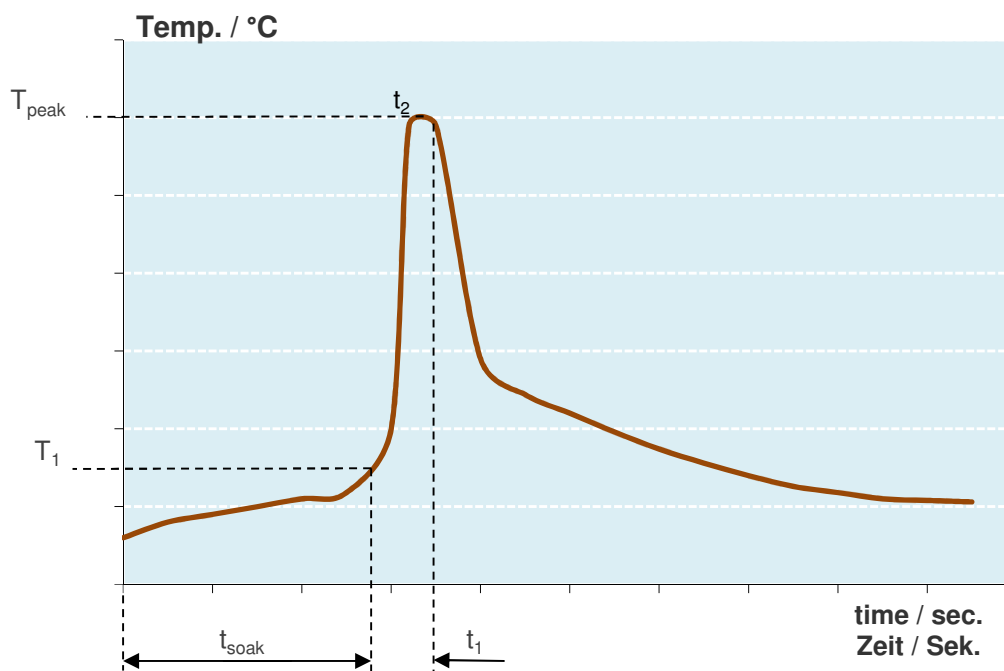
Part Number	5007.HSD.1X10.00Z	Teilenummer
Description	HSD - Anbaustecker HSD - pcb mount plug	Beschreibung

Soldering process / Lötprozess

Soldering methode/ THT - Wavebath solderability / Wellenlötbad
Lötmethode:

Recommended wave soldering profile /
Empfohlenes Lötprofil (Wellenbad):

Parameter	Reference	Specification
Temperature gradient in preheating / Temperaturgradienten in Vorwärmen		2°C/s max.
Soak time / Setzzeit	t_{soak}	< 30 seconds
Preheat temperature/Temperatur vorheizen	T_1	< 100° (-5/+5)°C
Temperature gradient time/ Temperaturgefälle (Zeit)	t_1	5-6 second
Soldering time / Lötdauer	t_2	10 Seconds max.
Peak temperature / Spitzentemperatur	T_{peak}	300°C max.
Temperature gradient in cooling/ Temperaturgradienten in Kühlung		6°C/Seconds max.



Product Data Sheet / Produkt Datenblatt

Part Number	5007.HSD.1X10.00Z	Teilenummer
Description	HSD - Anbaustecker HSD - pcb mount plug	Beschreibung

Soldering process / Lötprozess

Soldering methode / THR / Reflow
Lötmethode:

Recommended reflow soldering profil /
Empfohlenes reflow Lötprofil:

Parameter	Reference	Specification
Max. Temperature (lead free soldering) Max. Temperatur (bleifreies Löten)	C°	260°

